

Title (en)  
CONNECTING ELEMENT, MODULE CONNECTION, CIRCUIT BOARD ARRANGEMENT AND METHOD FOR FABRICATION OF A CONNECTING ELEMENT

Title (de)  
VERBINDUNGSELEMENT, BAUGRUPPENVERBINDUNG, LEITERPLATTENANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES VERBINDUNGSELEMENTS

Title (fr)  
ÉLÉMENT RACCORD, RACCORD POUR MODULES, DISPOSITIF DE CARTE DE CIRCUITS IMPRIMÉS ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN ÉLÉMENT RACCORD

Publication  
**EP 3627635 A1 20200325 (DE)**

Application  
**EP 18195460 A 20180919**

Priority  
EP 18195460 A 20180919

Abstract (en)  
[origin: US2020091636A1] Embodiments of a connecting element for connecting a first electrical assembly to a second electrical assembly may comprise a rigid, tubular outer housing made of an electrically conductive material and an electrical cable running inside the outer housing along a longitudinal axis of the outer housing. The electrical cable may include at least one inner conductor and a dielectric layer surrounding the at least one inner conductor. At least one segment of the outer housing may be reshaped along the longitudinal axis in such a way as to fix the electrical cable inside the outer housing.

Abstract (de)  
Die Erfindung betrifft Verbindungselement (4) zur Verbindung einer ersten elektrischen Baugruppe (2) mit einer zweiten elektrischen Baugruppe (3), umfassend ein starres, rohrförmiges Außengehäuse (5) aus einem elektrisch leitfähigen Material und ein in dem Außengehäuse (5) entlang einer Längsachse (L) des Außengehäuses (5) geführtes elektrisches Kabel (6). Das elektrische Kabel (6) weist wenigstens einen Innenleiter (7) und ein den wenigstens einen Innenleiter (7) umhüllendes Dielektrikum (8) auf. Wenigstens ein Abschnitt (A) des Außengehäuses (5) entlang der Längsachse (L) ist derart umgeformt, dass das elektrische Kabel (6) in dem Außengehäuse (5) fixiert ist.

IPC 8 full level  
**H01R 24/54** (2011.01); **H01R 12/73** (2011.01); **H01R 24/50** (2011.01); **H01R 43/16** (2006.01)

CPC (source: CN EP US)  
**H01B 13/004** (2013.01 - US); **H01R 12/7082** (2013.01 - EP US); **H01R 12/71** (2013.01 - CN); **H01R 12/716** (2013.01 - EP US); **H01R 24/40** (2013.01 - US); **H01R 31/06** (2013.01 - CN US); **H01R 43/18** (2013.01 - US); **H01R 43/20** (2013.01 - CN); **H01R 43/24** (2013.01 - US); **H01R 12/91** (2013.01 - EP); **H01R 13/6277** (2013.01 - EP); **H01R 24/50** (2013.01 - EP); **H01R 24/54** (2013.01 - EP); **H01R 24/58** (2013.01 - EP); **H01R 43/058** (2013.01 - EP); **H01R 43/16** (2013.01 - EP); **H01R 43/28** (2013.01 - EP); **H01R 2103/00** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [XYI] JP 2006260898 A 20060928 - AUTO NETWORK GIJUTSU KENKYUSHO, et al
- [XI] EP 1440834 A1 20040728 - HONDA MOTOR CO LTD [JP]
- [Y] CA 2246400 A1 19941110 - MOORE BOYD B [US]
- [A] DE 202015007010 U1 20151022 - ROSENBERGER HOCHFREQUENZTECH [DE]

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 3627635 A1 20200325**; **EP 3627635 B1 20221102**; CN 110932003 A 20200327; CN 110932003 B 20240312; EP 3627636 A1 20200325; EP 3627636 B1 20201104; EP 3627636 B2 20231108; FI 3627635 T3 20230322; US 11251551 B2 20220215; US 11251552 B2 20220215; US 2020091636 A1 20200319; US 2020373694 A1 20201126

DOCDB simple family (application)  
**EP 18195460 A 20180919**; CN 201910886405 A 20190919; EP 18215544 A 20181221; FI 18195460 T 20180919; US 201916574778 A 20190918; US 202016991289 A 20200812